

**性能特点：**

- 频带：10-18GHz
- 插入损耗：0.6dB
- 插损波动：±0.3dB
- 隔离度：22dB
- 输入回波损耗：18dB
- 输出回波损耗：22dB
- 芯片尺寸：1.18mm×1.0mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-PD31018 是一款 GaAs MMIC 0°三路功分器芯片，该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、易集成等特点，其频率范围覆盖 10~18GHz。

**电参数：** (  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  )

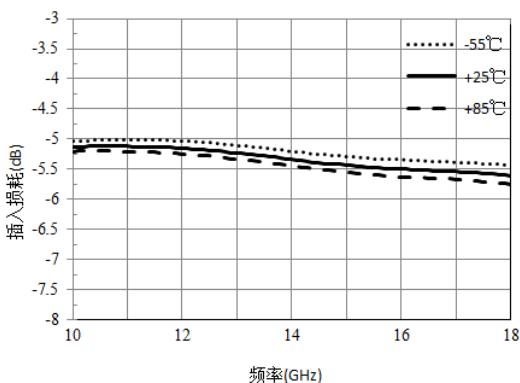
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	10~18			GHz
插入损耗	-	0.6	0.8	dB
插损波动	-	±0.3	-	dB
隔离度	22	-	-	dB
输入回波损耗	18	-	-	dB
输出回波损耗	22	-	-	dB

**使用限制参数：** (超过以下任何一项最大限额都有可能造成永久损坏)

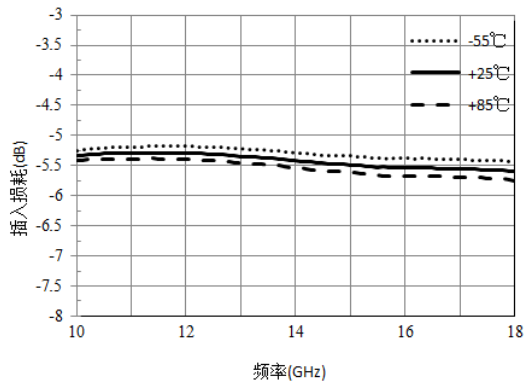
输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+85°C

**典型曲线：**

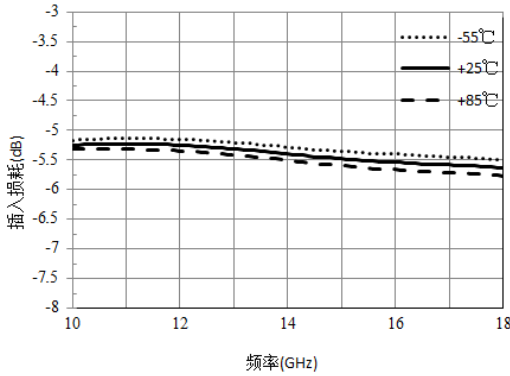
2 端口插入损耗



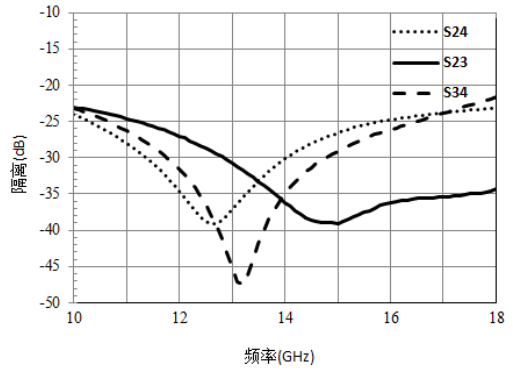
3 端口插入损耗



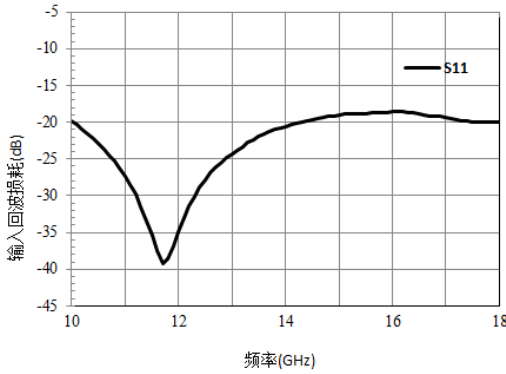
4 端口插入损耗



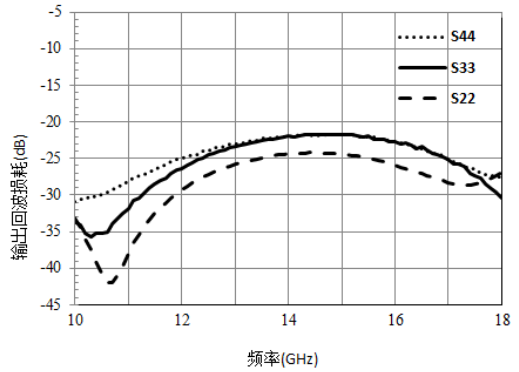
隔离度



输入回波损耗

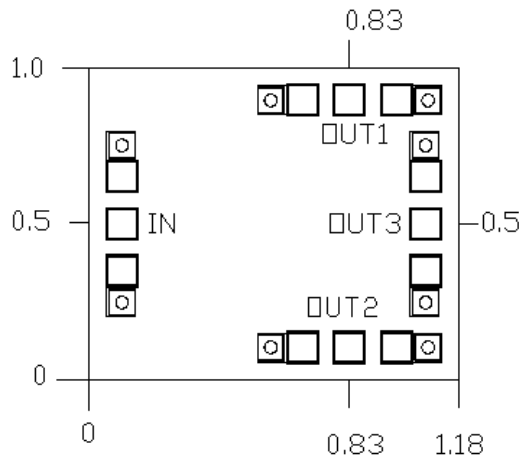


输出回波损耗

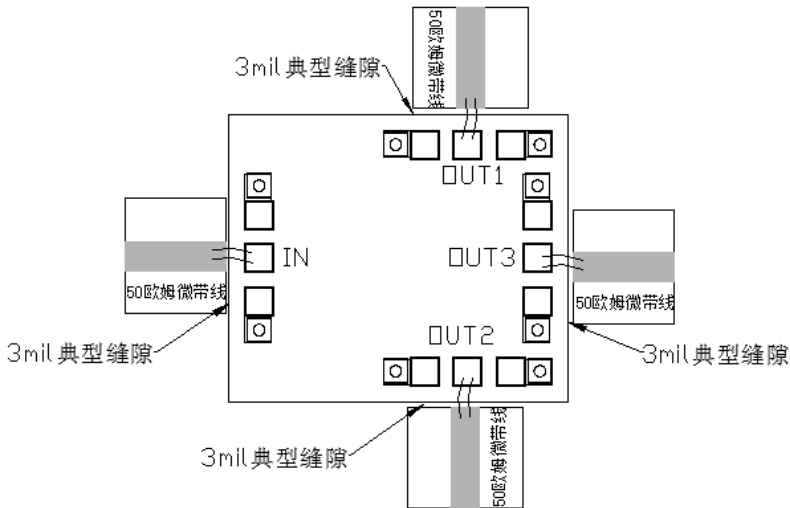


08  
功分器

尺寸图：(单位 mm)



**建议装配图：**



**使用说明：**

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。